

证券代码：600183

证券简称：生益科技

广东生益科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：202404

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
会议召开方式	上证路演中心视频录播和网络互动
时间	2024年04月09日上午10:00-11:30
地点	上海证券交易所上证路演中心
上市公司接待人员姓名	董事长：刘述峰先生 董事、总经理：陈仁喜先生 董事会秘书：唐芙云女士 总会计师：何自强先生 独立董事：卢馨女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 今年覆铜板上游原材料铜，玻纤布等都在涨价，公司今年覆铜板有没有提价，目前还没有公司提价的消息，是不是目前上游原材料涨价成本都有公司自己承担了，并没有转嫁给下游？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！我们持续观察未来的市场情况，根据市场及材料变化，及时调整经营策略，采取相关措施应对。敬请关注。</p> <p>2. 公司在咸阳开发的生益金华1号房地产项目，去年就开盘销售了，今年卖出去的期房会算入公司今年营收业绩里面吗？还是等以后交房才能算入公司营收业绩？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！依据会计准则相关规定，需要交房之后才确认公司收入，目前收到的款项确认为合同负债（即预收款</p>

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>项)。谢谢关注。</p> <p>3. 请介绍一下公司载板业务的发展情况，认证情况与技术进展，以及 abf 载板。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司在较早期就在封装载板用基板材料方面做了相关技术布局，对标该领域内的国际标杆企业，覆盖了不同材料技术路线，并和终端进行专属基板材料开发应用。不同封装形式对材料的要求也不同，我们已在 Wire Bond 类封装基板产品大批量应用，主要应用于传感器、卡类、射频、摄像头、指纹识别、存储类产品领域，并且已在先进封装领域有批量应用，同时已在更高端的以 FC-CSP、FC-BGA 封装为代表的 AP、CPU、GPU、AI 类产品进行开发和应用。谢谢关注。</p> <p>4. 公司超低损耗 ccl 对北美大客户 AI 服务器项目认证做的如何了，预计今年什么时候能正式供货呢？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司正积极配合 PCB 客户的新品交付和项目认证。谢谢关注。</p> <p>5. 铜价最近大幅上涨，公司覆铜板有没有涨价计划呢</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！我们持续观察未来的市场情况，根据市场及材料变化，及时调整经营策略，采取相关措施应对。谢谢关注。</p> <p>6. 请问公司在 NVIDIA 供应链的主要客户？B100/GB200 相关产品是否已过认证？预期出货时间？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！我司超低损耗产品已通过多家国内及北美终端客户的材料认证，目前正处于产品项目的认证中。谢谢关注。</p>
----------------------	--

7. 公司最近产能利用率如何

答：尊敬的投资者，您好！目前公司满负荷生产。谢谢关注。

8. 唐总好，感谢今年的慷慨分红，未来贵司在分红方面会保持怎样一个水平，谢谢.

答：尊敬的投资者，您好！感谢对公司的认可与支持。公司秉承“股东、员工、社会”三共享原则，自 1998 年上市至今 25 年来坚持连续每年实施现金分红，现累计分配现金红利 94.18 亿元(含税)，但公司通过 IPO、非公开发行及发行可转债，共募集资金净额为 33.55 亿元，现金分配总额是募集资金净额的 2.8 倍。其中 2020-2022 年度，公司含税现金分红数额占分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别是 54.54%、49.09%、68.82%。2023 年度的分红尚需经股东大会审议，以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 2,354,629,880 股为基数进行测算，2023 年度现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 91.03%。关于后续的分红情况，敬请投资者留意公司在上交所网站及指定媒体披露的相关公告。谢谢关注。

9. AI PC 与 AI 手机对公司相关业务的发展是否是重大利好呢，AI PC 会使用到高速覆铜板吗

答：尊敬的投资者，您好！公司覆铜板是作为算力的硬件支撑，有相应产品系列满足不同客户需求。公司高速产品有全系列布局，包括 Mid-loss、Low-loss、Very Low-loss、Ultra Low-loss、Extreme Low-loss 及更高级别材料，可以满足不同应用领域的需求。谢谢关注。

10. 公司的超低损耗 CCL 北美客户认证通过了吗？目前量产没有？

答：尊敬的投资者，您好！我司超低损耗产品已通过多家国内及

北美终端客户材料认证，目前正处于产品项目的认证中。谢谢关注。

11. 请说一下新一代 EGS 平台服务器最近发展情况，升级换代有无提速

答：尊敬的投资者，您好！针对新一代 EGS 平台服务器，根据目前市场已有信息来看，预计海外客户 2024 年渗透率会达到 50-70%左右，国内客户 2024 年渗透率大概会在 40-50%。以上信息仅供参考。谢谢关注。

12. 请详细介绍一下公司 AI 服务器业务的发展，包括英伟达芯片 AI 服务器，与国产晟腾芯片 AI 服务器。

答：尊敬的投资者，您好！公司跟国内外各应用领域的头部终端，都保持密切合作，配合终端开发更具性能挑战的各种类型材料。目前公司超低损耗材料已通过多家北美及国内终端客户材料认证。谢谢关注。

13. 英伟达 GB200 采用铜缆连接，公司有无相关的背板技术

答：尊敬的投资者，您好！铜缆连接技术与板材无直接关系，主要是铜线缆和 PCB 设计，我司已通过终端认证的超低损耗材料都可以应用于背板设计。谢谢关注。

14. 请问刘总，对于今年覆铜板行业大家的观点目前看比较谨慎（更多认为是上半年不乐观，Q4 会可能同比增长），但证券公司分析师预测贵司业绩 2024 年同比会是增长的，您怎么看。目前行业真正的挑战是什么？如上游原材料涨价如铜等还是下游需求没有真正起来。AI 服务器如果真正能够上量，对公司业绩、长远发展的影响又是怎样的？感谢了。

答：尊敬的投资者，您好！对于电子产业来说，2024 年是挑战

和机遇并存，需要在多变的市场中保持警醒，在复杂形势中破局而出。展望 2024 年，市场需求应该会有所好转，但供过于求的基本格局短期内不会改变，就 CCL 行业而言，我们认为 2024 年将会是竞争格局开始出现分化的一年，我们要运用我们的产能优势、品质稳定优势、系统管理优势进一步抢占市场，同时推进海外市场开拓和泰国工厂的建设，争取用较短时间形成国内、国外市场均衡发展的态势。

电子行业仍是技术进步最快、新产品层出不穷，市场创新最活跃的产业，也是技术迭代最快的行业，因此，能否保持高强度的技术投入，让公司的产品能够一直与市场的需求保持同步，是企业面临的巨大挑战，也是致胜法宝。

AI 技术今年会渗入各类电子产品中，比如今年被称为“AI PC 的元年”，“AI 手机的元年”，以及 AI 芯片将进入汽车领域，不仅仅是服务器。AI 的进入必将拉动电子工业一轮新的新品和消费高潮，对此，我们可以寄予重大关注和期待！相信 AI 技术将会推动行业业绩的好转。

谢谢关注。

15. 刘总好。目前大家对覆铜板形势看法比较谨慎，认为上半年不乐观，最多 Q4 会有可能增长。但一些证券公司分析师报告中认为贵司 2024 年业绩会有增长，请问您怎么看。

第二个问题。目前覆铜板行业最大的挑战来自于哪里？上游原材料涨价如铜 还是下游需求没有放量，还是行业内产能过剩，互相杀价？ 谢谢了

答：尊敬的投资者，您好！电子行业仍是技术进步最快、新产品层出不穷，市场创新最活跃的产业，也是技术迭代最快的行业，因此，能否保持高强度的技术投入，让公司的产品能够一直与市场的需求保持同步，是企业面临的巨大挑战，也是致胜法宝。谢谢关注。

16. 陈总好。恭喜贵司通过 AI 服务器认证，请问这个产品对于贵司业绩影响、综合竞争力的影响具体是怎样的。

第二个问题，今天看到了贵司的可视化财报，非常直观，给个 。相比而言，20221 年 25.28 亿元归母净利润，24.34%净资产收益率，都是一个高峰。展望未来，您认为还需要多长时间能够再次超过这一顶峰，3 年/2027 年还是 5-6 年/2030 年？

答：尊敬的投资者，您好！随着电子技术的进步，信号传递的速度越来越快且数据通过量也越来越大，因此，对电子材料的覆铜板提出了低损耗的要求，也就是我们俗称的“高速材料”。我们公司持续在“高速”领域投入技术研发已超过十数年，并已根据市场需求推出一代代的产品以应对客户的不同需求。AI 服务器所需的材料是其中之一，手机、PC 等等领域均在使用 AI 技术，所有这些应用都将推动我们整个行业的业绩改善，对此，我们充满期待。

2021 年无疑是我们公司的一个历史新高，也是我们覆铜板行业乃至全球 PCB 行业的一个新高。随着需求的逐渐恢复，我们可以预计 2024 年的销量将超过 2021 年。随着各种市场因素的好转，电子工业的景气、原材料的价值回归等等，我们期望在不远的未来将迈上一个新的高峰。

谢谢关注。

17. 今年是 5.5G 商用发展元年，怎么看待其对公司的机遇

答：尊敬的投资者，您好！根据行业公开信息，2024 年是 5G-A 商用元年，中国移动已经进入商用部署阶段，中国电信已经进入商用验证阶段、中国联通已经发布创新示范成果。根据 3 月份中国移动公布信息，2024 年底 5G-A 网络部署城市超 300 个，按照整体规划，中国移动将分阶段实现 5G-A 全覆盖：第一波 5G-A 商用启动期（商用元年），2024 年底覆盖超 300 个城市；第二波

	<p>5G-A 规模发展期（2025 年），通感一体&网络 AI 应用&无源物联&XR 多媒体增强规模商用；第三波 5G-A 全量商用期（2026 年），探索星地融合&绿色低碳。据三大运营商公布信息，5G-A 商业前景较好，产品形态更加丰富，公司相关的系列产品成熟，布局完整，市场进展顺利，是 5G-A 网络硬件 PCB 基材的核心主力供应商。谢谢关注。</p> <p>18. 目前覆铜板市场供需情况如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！目前公司满负荷生产。谢谢关注。</p> <p>19. 请问陈总，对于上游原材料涨价如铜，玻纤布等，是否有相关预案以减少对企业利润的影响。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！目前的原材料正处于一个低水平，存在原材料涨价的冲动和可能，我们已制定了相应的预案应对，相信对公司的冲击和影响有限。谢谢关注。</p>
日期	2024 年 4 月 9 日